



華潤勵致有限公司

二零零七年全年業績公佈

2008年3月20日

華潤集團旗下香港上市公司



目錄

- **2007年財務報告摘要**
- **2007年業務發展報告**
- **2007年重大收購及出售事項**
- **透過新購業務，重新定位**



2007年全年業績公佈

- 營業額創新高達**42.6**億港元，增長**24%**
- 半導體業務快速增長，營業額升至**30.17**億港元，增長**45%**
- 出售壓縮機業務，公司轉型為專業的半導體公司
- 合併勵致及上華之半導體業務，組成華潤微電子有限公司
- 財務基礎穩健，資產素質良好，**2007**年經營性現金流及手持現金分別**4.46**億港元及**8.68**億港元





2007年財務報告摘要

整體業績表現

年度 指標	截止2007年 12月31日止 (百萬港元)	截止2006年 12月31日止 (百萬港元)	增 / (減) 幅度
營業額	4,264	3,451	24%
毛利	997	848	18%
經營業務的現金流入淨額	446	564	(21%)
經營利潤	359	359	0%
股東應佔溢利	152	232	(34%)
毛利率	23%	25%	絕對值 - 2%
經營利潤率	8%	10%	絕對值 - 2%
每股盈利 (基本)	5.48 仙	8.57 仙	(36%)
每股盈利 (攤薄)	5.37 仙	8.49 仙	(37%)
中期股息(每股)	1.00 仙	1.00 仙	0%
建議末期股息 (每股)	--	1.00 仙	(100%)

註: 股東應佔溢利下降, 主要由於:

- 年內出售壓縮機業務導致貢獻減少
- 結束半導體業務於香港廠房產生之虧損



2007年財務報告摘要

穩健的流動資金及負債水平

指標	年度	截止2007年 12月31日止年度	截止2006年 12月31日止年度
經營性現金流對利息覆蓋率 (倍)		4	6
資本負債比率 (%)		28%	45%
資產負債比率 (%)		14%	22%
經營性現金流入(港元)		4.46 億	5.64 億
股東資金 (港元)		30.5 億	27.6 億
手持現金 (港元)		8.68 億	5.21 億

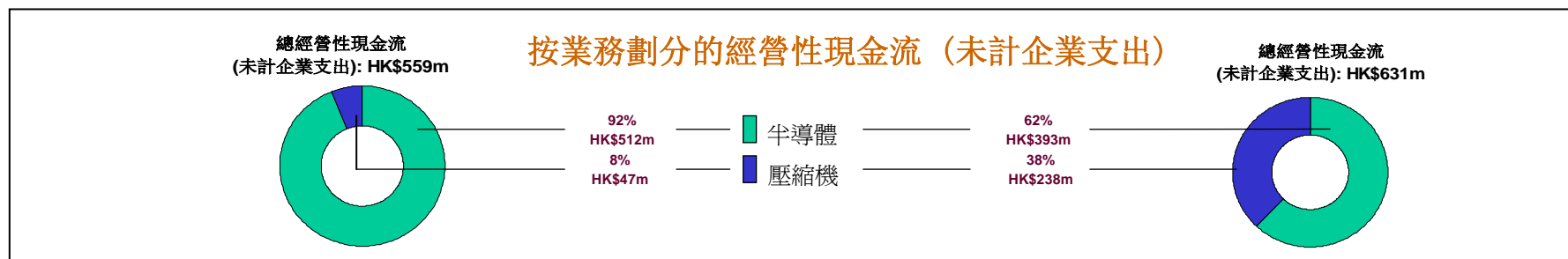
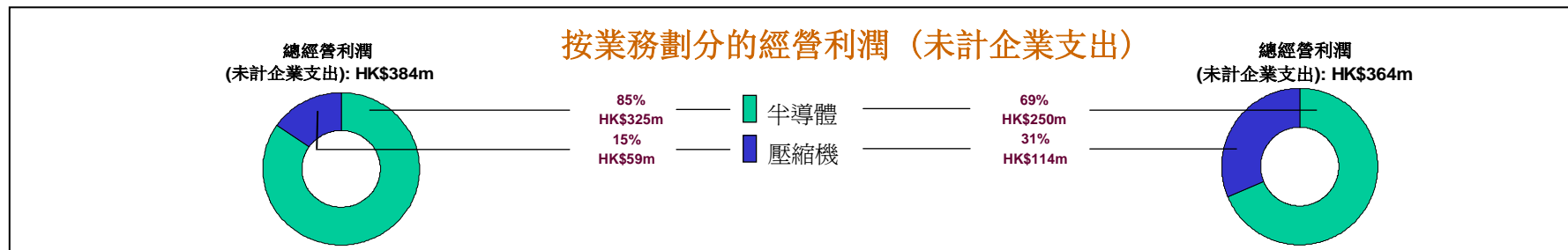
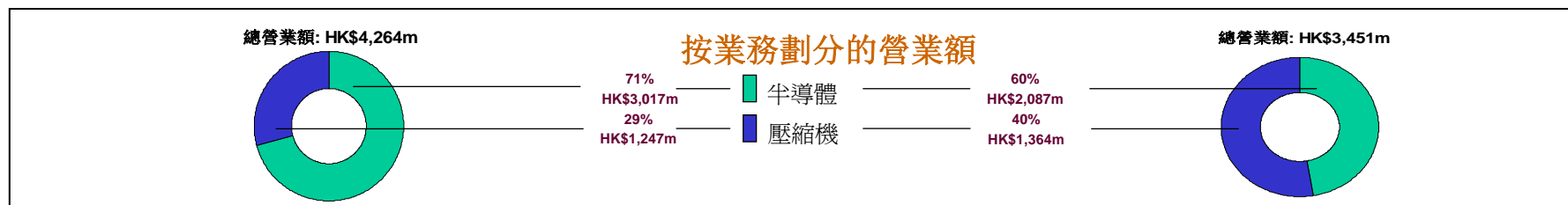


2007年財務報告摘要

業務結構優化，微電子業務比例大幅度上升

31.12.2007

31.12.2006





2007年財務報告摘要

■ 半導體業務

2007年業績表現持續改善，營業額升至**30.17億港元**，增至**45%**



期間 指標	年度	截至2007年 12月31日止	截至2006年 12月31日止	增 / (減) 幅度
營業額		30.17 億港元	20.87 億港元	45%
經營利潤		3.25 億港元	2.50 億港元	30%
經營性現金流入		5.12 億港元	3.93 億港元	30%
毛利率		27%	29%	絕對值 -2%
股東應佔溢利		1.29 億港元	2.36 億港元	(45%)

註：股東應佔溢利下降，主要由於：

- 封裝及測試業務正處於產能提升階段，盈利貢獻有限
- 結束一家生產廠房虧損所產生之虧損



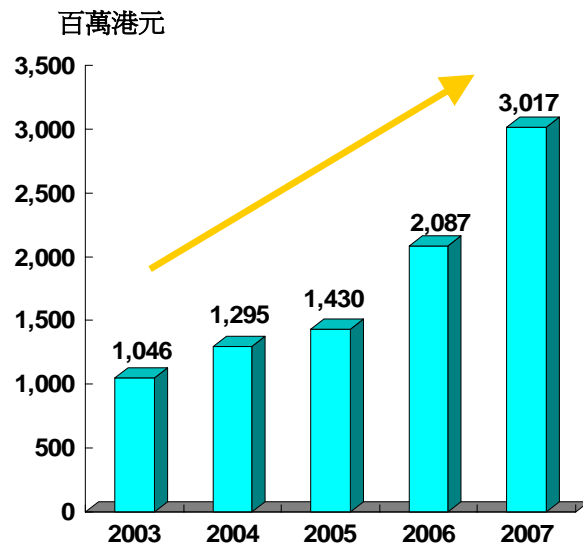
2007年財務報告摘要

■ 半導體業務

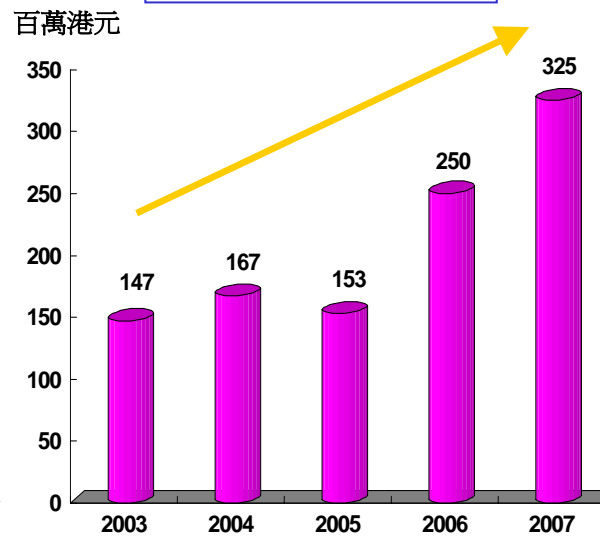
保持快速成長勢頭



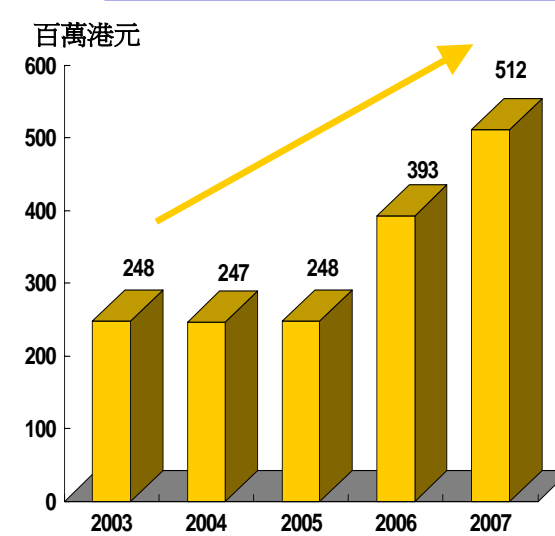
營業額



經營利潤



經營性現金流入





2007年財務報告摘要

半導體各業務2007年財務表現



業務	營業額	毛利率	經營利潤率	淨利潤率	資本性支出
IC設計	9.80 億港元	18%	2%	1%	3,200 萬港元
晶圓代工	12.84 億港元	23%	10%	6%	4.69 億港元
IC封測	3.80 億港元	10%	10%	0%	1.54 億港元
分立器件	8.67 億港元	21%	12%	11%	1.69 億港元
內部對沖/配套設施 及其他	-4.94 億港元	-	-	-	1.03 億港元
合計	30.17 億港元	27%	11%	5%	9.27 億港元



2007年財務報告摘要

■ 壓縮機業務

2007年業績仍然受行業週期產能過剩及
原材料價格上漲影響



年度 指標	截至2007年 12月31日止	截至2006年 12月31日止	增/(減) 幅度
營業額	12.47 億港元	13.64 億港元	(9%)
經營利潤	5,900 萬港元	1.14 億港元	(48%)
經營性現金流入	4,700 萬港元	2.38 億港元	(80%)
毛利率	15%	18%	絕對值 - 3%
股東應佔溢利 (63.75%)	3,000 萬港元	6,000 萬港元	(50%)

2007年業務發展報告



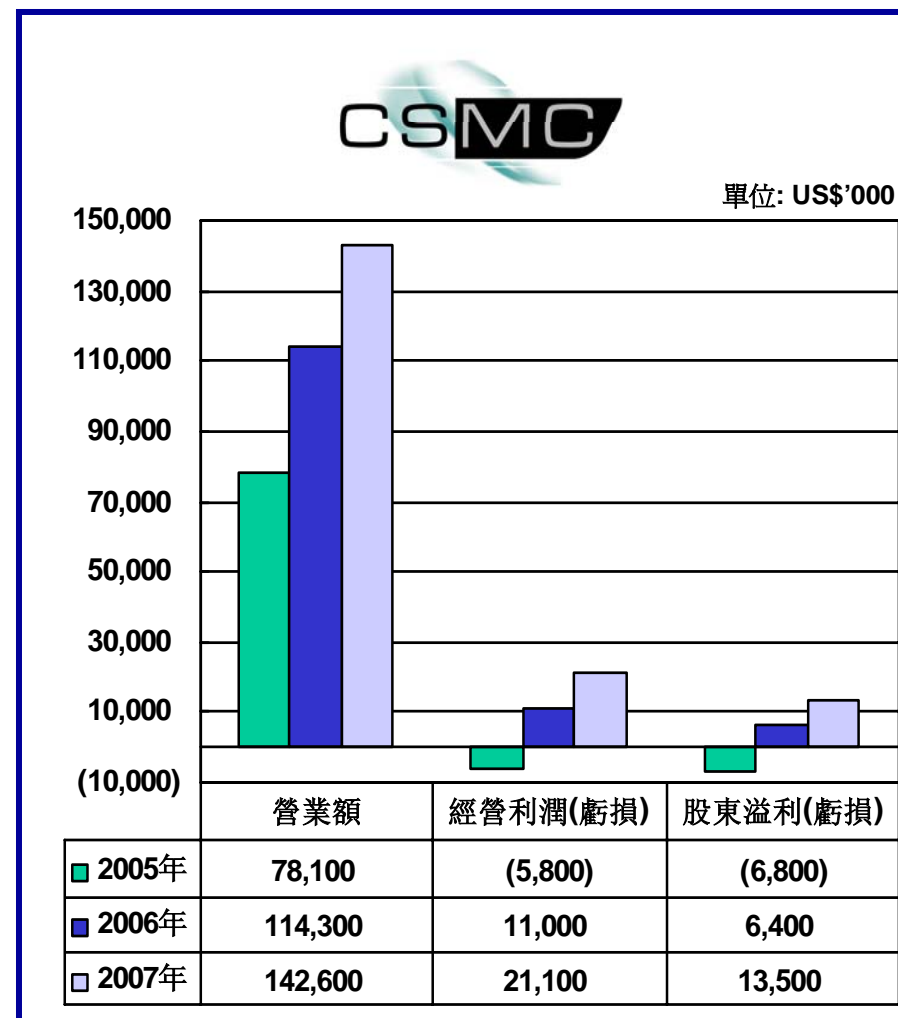
2007年業務發展報告

- **設計業務**——業績增長、地位提升
 - 主要負責該業務的華潤矽科在國內排名第**6**位
 - **2004**年成立的華潤矽威公司主要從事於電源管理**IC**
 - **2006**新成立的**IPS**公司，其開發的功率產品已開始進入市場



2007年業務發展報告

- 晶圓代工業務——表現理想
 - 華潤上華營業額及經營利潤分別為**1億4,260萬美元**及**2,110萬美元**，分別增加**25%**及**92%**
 - 表現理想主要受惠於公司着力開發產品附件值高的模擬集成電路產品表現突出





2007年業務發展報告

- **IC封測業務**——客戶結構優化，進入國際市場
 - 與**STATS ChipPAC**合作項目按計劃推進
 - 國際半導體市場拓展工作理想
 - 已通過日本東芝質量認證並量產
 - 已通過美國**Intersil**，韓國**KEC**質量認證，已開始批量生產
 - 已通過美國**Cirrus Logic** 的質量認證，開始小批量生產
 - 已通過**IBM**質量認證，開始小批量生產
 - **STM、ATMEL**等公司的質量認定正在進行中



2007年業務發展報告

■ 分立器件業務——快速發展

- 為國內最大的功率半導體分立器件芯片開發商和生產商之一，**2007年**銷售量比去年同期顯著增長
- 分立器件晶圓生產線已從**4英吋**生產線逐步轉型至**5英吋**生產線，較大幅度地降低了成本，提高了品質及效率

2007年重大收購及出售事項



2007年重大收購及出售事項

■ 出售壓縮機業務

- 於**2007年6月21日**公佈以代價**11.7億港元**向華潤(集團) 出售全部壓縮機業務，於**2007年8月16日**完成交易
- 代價相等於壓縮機業務截至**2006年12月31日**止
 - 年度未經審核綜合除稅後純利約**20倍**
 - 應佔未經審核綜合資產淨值約**10%溢價**
- 體現大股東對勵致的大力支持
- 勵致成為單一業務公司，專注發展半導體業務



2007年重大收購及出售事項

■ 合併半導體業務

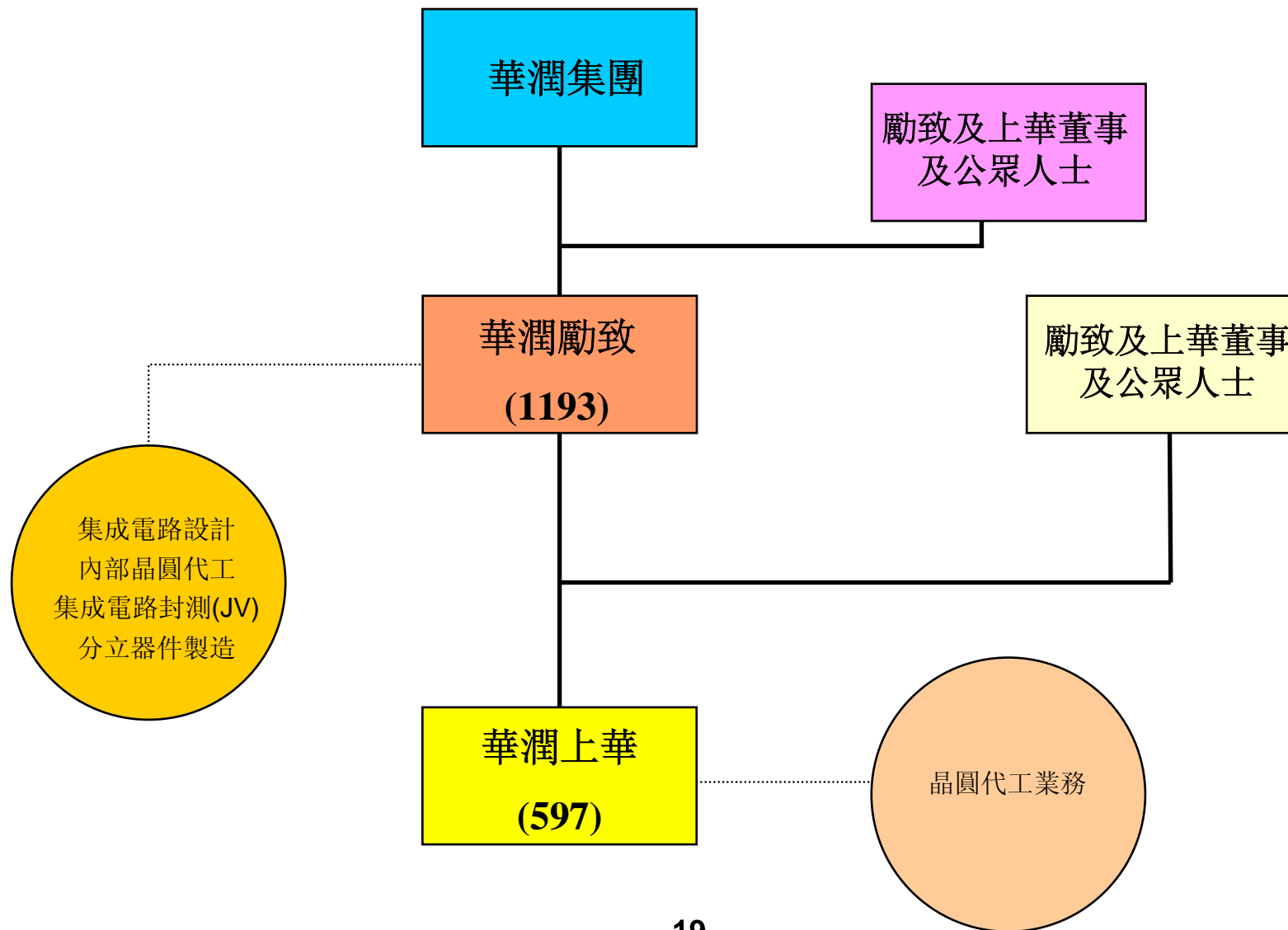
■ 於2007年12月4日公佈:

- 半導體業務與華潤上華合併
- 向華潤(集團)之全資附屬公司收購中港混凝土有限公司
- 華潤勵致資本重組
- 華潤上華更改公司名稱成為華潤微電子有限公司 (“華潤微電子”)



2007年重大收購及出售事項

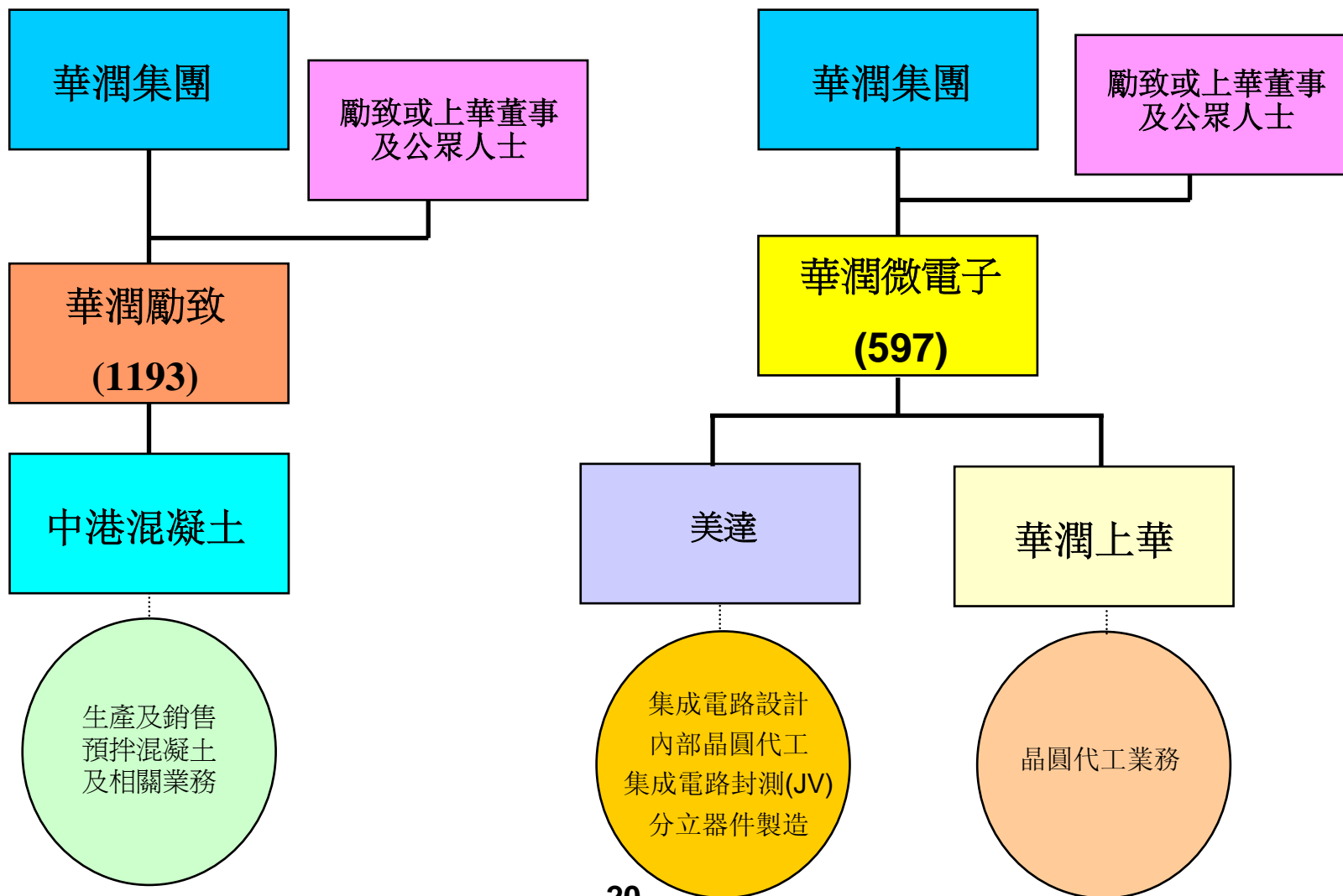
重組前華潤勵致股權架構





2007年重大收購及出售事項

重組後華潤勵致及華潤微電子股權架構





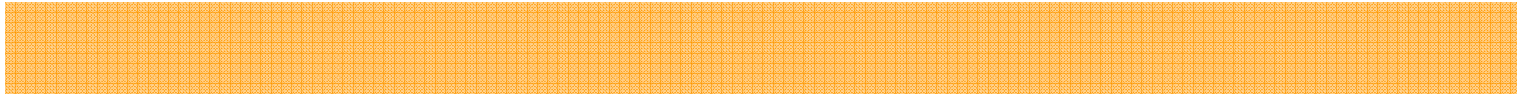
2007年重大收購及出售事項

- 經合併的華潤微電子有限公司將透過內部增長、外部收購及物色機會與海外及中國企業組成策略性夥伴，以繼續擴充其半導體業務。



透過新購業務，重新定位

- 重新定位為建造及工程行業主要供應商。
- 出售半導體業務及收購中港混凝土有限公司後，華潤勵致將轉型為預伴混凝土供應商。隨著本地物業市場復甦，以及香港的建造項目穩定增長，新收購業務的表現預期將進一步有所改善。華潤勵致將重新定位為香港建造及土木工程行業的主要預伴混凝土供應商。



多謝!